

New

LS-Y355 UVレーザー微細加工システム

- ・試作・準生産に適した微細加工用UVレーザーシステム
- ・全固体QスイッチパルスUVレーザー（波長355nm）を組み込み
- ・2軸ガルバノスキャナー、fθレンズにより、マスクレスな加工
- ・ワーク X300mm x Y300mmステージにより広範な加工エリア



加工対象物

金属、シリコン、ガラス、セラミックス、樹脂、薄膜エッチング

加工穴サイズ

φ30μm～20μm（材料・光学系／ワーク仕様による）

fθレンズ

加工エリア φ40mm（他、φ100mmもあり）

ワークステージ X300mm x Y300mm（サイズ変更可）

Low spec：繰り返し位置決め精度 ±20μm 分解能 10μm

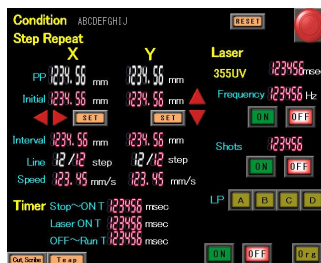
High spec：繰り返し位置決め精度 ±2μm 分解能 0.5μm

*Z軸、回転軸 オプション

355nm UVレーザー光源

2W、7W、10W、14W、23W 用途、コストパフォーマンスより選択
既にご選定・ご所有のレーザーとの組み合わせも可能です。

基本操作 PLCタッチパネルにより、視認し扱いやすい操作



Step & Repeat 設定画面

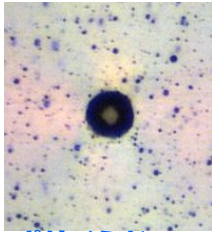


条件設定画面

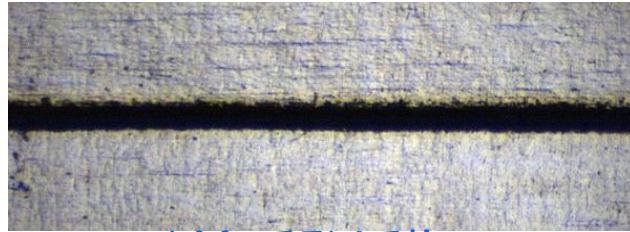


設置イメージ

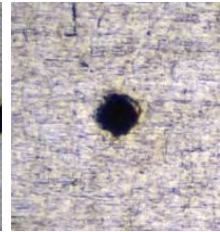
加工例



ポリイミド
穴径 30 μm

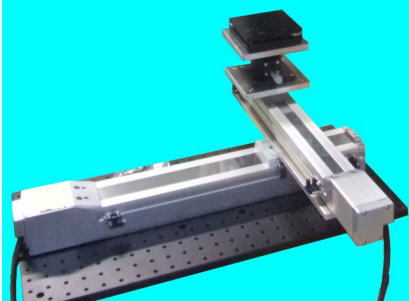


t=0.1mm ステンレス材
溝幅 25 μm



ステンレス材
穴径 30 μm

ワークステージ



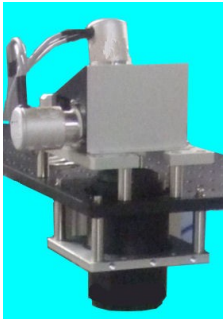
Low spec XYステージ



High spec XYステージ (Aerotech社製)

* ステージストローク、精度、移動速度等、ご要望条件により、変更します。

XYガルバノスキャナー fθレンズ光学系



他の波長提案も行えます。

- ・ 1064nm (基本波)
- ・ 532nm (2倍波)
- ・ 266nm (4倍波)

その他

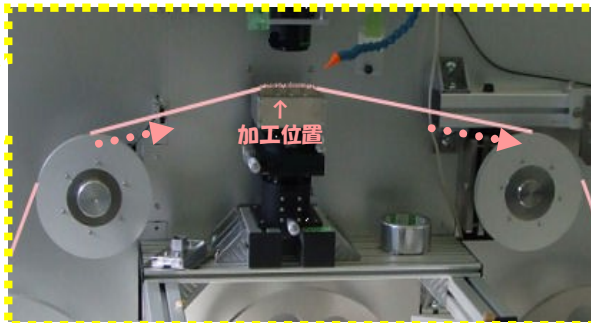
- ・ レーザクラス4対応
- ・ キースイッチ、インターロック、
- ・ 緊急停止、警告表示灯、
- ・ 完全遮蔽カバー
- ・ Off-set 観察モニター

オプション

- ・ ビームフロファイラー
- ・ パワーモニター
- ・ ワーク高 モニターセンサー

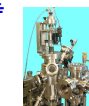
様々な応用例

フレキシブルなテープ上の材料へのレーザ加工例



取り扱い製品

- ・ UVレーザ加工機
- ・ 真空装置、システム
- ・ スパッタ、PLD、電子ビーム蒸着装置 等
- ・ レーザ発振器、光学コンポーネント
- ・ PLD用導入光学系、UVミラー、レンズ、
- ・ プログラマブルレーザスキャン光学系
- ・ 真空コンポーネント
- ・ 合成石英窓、RHEEDガン、RHDスクリーン、等



AOV ADVANCED OPTICS VACUUM

AOV株式会社 www.aov.co.jp

193-0832 東京都八王子市散田町3-1-1
登志ビル4F

E-mail : info@aov.co.jp

Tel : 042-686-1511

Fax : 042-668-5101